

2026年2月3日

ソフトバンク株式会社
SAIMEMORY株式会社

ソフトバンク子会社のSAIMEMORYとインテル、 次世代メモリー技術の実用化に向けて協業

～共同で研究開発を推進して、2029年度中の実用化を目指す～

ソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：宮川潤一、以下「ソフトバンク」）の100%子会社であるSAIMEMORY株式会社（サイメモリ、本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：山口秀哉、以下「SAIMEMORY」）は、高容量・広帯域・低消費電力を特長とする次世代メモリー技術「ZAM」（Z-Angle Memory）の実用化に向けて、2026年2月2日に Intel Corporation（以下「インテル」）との協業契約を締結しました。

SAIMEMORYは、ソフトバンクが次世代メモリー技術の実用化に向けた研究開発を推進することを目的に、2024年12月に設立した子会社です。SAIMEMORYは、インテルが米国エネルギー省の支援を受けて推進しているAdvanced Memory Technology (AMT) プログラム※1で確立された次世代メモリーの基盤技術や、Next Generation DRAM Bonding (NGDB) イニシアチブ※2で実証された技術的知見を活用し、革新的なメモリー開発技術や製造技術の研究開発を進めています。2027年度中にはプロトタイプを作製して、2029年度中の実用化を目指します。この次世代メモリー技術「ZAM」により、大規模なAI（人工知能）モデルの学習や推論処理を必要とするデータセンターなどにおいて、大容量かつ広帯域なデータ処理や処理性能の向上、消費電力の削減の実現に向けて取り組みます。

ソフトバンクは、SAIMEMORYを通じた次世代メモリー技術の開発を、次世代社会インフラを支える重要な取り組みの一つと位置付けています。今後もインテルや国内外の技術パートナーなどとの連携を通して、日本発の先進的な半導体技術の創出と国際競争力の強化に貢献していきます。

※1 次世代メモリー技術の基盤確立を目的に、米国エネルギー省の支援の下で推進されている研究開発プログラム

※2 次世代DRAM（コンピューターやサーバーの主記憶装置として活用される高速メモリー）の性能と電力効率を大幅に高めることを目的に、インテルが主導して進めている技術開発の取り組み